

证券代码：688037

证券简称：芯源微

沈阳芯源微电子设备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-04

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd. Octo Rivers Asset Management (HK) Limited 德邦基金管理有限公司 东吴基金管理有限公司 福州开发区三鑫资产管理有限公司 国华兴益保险资产管理有限公司 海通创新证券投资有限公司 华安财保资产管理有限责任公司 南方基金管理股份有限公司 诺德基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 上海景林资产管理有限公司 上海磐耀资产管理有限公司 上海人寿保险股份有限公司 上海世诚投资管理有限公司 上海水璞私募基金管理中心(有限合伙) 上海拓聚投资管理有限公司 申万宏源证券有限公司 深圳安瑞置业顾问有限公司 泰信基金管理有限公司 西部证券股份有限公司

	<p>永赢基金管理有限公司 长江证券股份有限公司 中国国新控股有限责任公司 中国人民财产保险股份有限公司 中国中信金融资产管理股份有限公司 HCEP Management Limited 博裕资本有限公司 富国基金管理有限公司 光大证券股份有限公司 国泰基金管理有限公司 瑞士百达资产管理 上海宁泉资产管理有限公司 兴业基金管理有限公司 中信建投证券股份有限公司</p>
时间	2024年6月27日
地点	上海证券大厦
上市公司接待人员姓名	<p>副总裁 崔晓微 财务总监 张新超 董事会秘书 刘书杰 证券事务代表 李 辰</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于6月27日参加中国科学院控股有限公司与中信建投证券联合举办的2024年“科技引领·共创未来”上市公司集中路演活动，当日上午公司副总裁崔晓微在上交所路演大厅通过现场及线上直播的方式对公司做了公开路演推介，详细介绍了公司的发展历程、核心产品以及未来战略规划，当日下午公司财务总监张新超、董事会秘书刘书杰、证券事务代表李辰在上海证券大厦会议室与投资者进行了现场交流，交流中</p>

涉及的主要问题如下：

Q1：公司上半年签单情况如何？

上半年，公司整体签单情况良好，其中，前道涂胶显影及清洗以功率、逻辑等领域订单为主，后道先进封装景气度有所恢复，客户下单较为积极。随着公司产品成熟度的陆续提升以及产品系列的逐渐完善，公司客户粘性不断增强，稀缺赛道拳头产品前道涂胶显影整体性能持续提升，客户群体不断丰富，综合竞争力不断增强；高市占率产品前道物理清洗、后道先进封装等继续巩固国内市场龙头地位；战略性新产品前道化学清洗有序推进研发验证及客户端导入，有望为公司打造第二增长曲线。未来，公司将继续围绕前道涂胶显影、前道清洗（物理+化学）、后道先进封装（含 2.5D、HBM 等新兴领域）三大主力赛道，不断丰富产品矩阵，持续做大做强主业，实现公司可持续发展。

Q2：公司前道涂胶显影在下游客户的导入进展如何？

公司与国内各大晶圆厂均建立了较为紧密的合作关系，近几年在功率客户、某些逻辑及存储客户等导入进度较快，从 offline Track 到 inline Track 均实现了批量销售。目前，公司正在与多家国内知名的存储、逻辑客户紧密配合，加快推进相关机台的评估考核进程，与客户一道稳步推进机台性能的提升，为客户提供高性价比的国产化替代方案。

Q3：公司前道化学清洗新品在下游客户的评估导入情况如何？

今年 3 月，公司正式发布了战略性新产品前道化学清洗机，目前已与多家战略客户建立联系，计划于下半年陆续导入到多家存储、逻辑等客户开展工艺验证。公司前道化学清洗新品可覆盖前道 80%以上化学清洗工艺，产品对标国际龙头，围绕客户“痛点”，致力于解决客户卡脖子问题。

Q4：公司在 2.5D、HBM 等领域的新品拓展情况如何？

公司为国内先进封装领域龙头，传统优势产品包括涂胶、显影、湿法去胶、湿法刻蚀、湿法清洗等，已广泛应用于台湾台积电、长电科技、华天科技、通富微电、盛合晶微等国内高端封装头部客户。近年来，围绕下游客户对 2.5D、HBM 等高端工艺的研发需求，公司适时推出了临时键合、解键合、Frame 清洗等新品类，目前已通过国内某存储客户的工艺验证并实现重复销售，2024 年将继续向各大 2.5D 高端封装客户导入。目前，公司在临时键合领域已成功打破国外厂商垄断，实现进口替代，与各头部 2.5D、HBM 等厂商建立了紧密的联系。未来，随着国内 2.5D、HBM 等新兴产业的大发展，公司临时键合品类有望实现持续稳健增长。

Q5：公司对全年订单展望如何？

公司前道 Track 目前国产替代率仍然较低，offline、I-line、KrF 等较成熟品类正处于稳步放量阶段，浸没式产品也已完成 0 到 1 的突破，截至 23 年底，已获得国内 5 家重要客户订单，公司将快速推进浸没式产品的成熟和稳定进程。

公司前道物理清洗已成为国内逻辑、功率客户首选品牌，近年来持续巩固国内领先优势，23 年新推出的高产能物理清洗设备已进入国内重要存储客户端验证，有望打开新的增量市场。前道化学清洗已获国内重要客户验证性订单，目前已有多家客户进入到实质性的机台配置和商务谈判阶段，产业化进程迅速推进中。

后道先进封装行业目前已出现一定的复苏迹象，叠加 2.5D、HBM 等新技术领域的兴起，整体行业景气度良好，公司后道先进封装设备部分指标已实现国际领先，并获得了多家海外龙头客户的持续认可。

综合来看，公司对全年签单保持较为积极的态度。

Q6：公司对全年收入等业绩展望情况如何？

截至 23 年底，公司在手订单 22 亿元（含税），24 年上

	半年新签订单情况良好。截至目前，公司在手订单可以对 24 年收入提供一定支撑。
附件清单	无
本次活动是否涉 及应当披露重大 信息	不涉及